



## Ball-Wedge Bonder 5310

### Bond System

<b>Drahttypen</b>	Golddrähte 17,5-50µm auf 2"-Spule
<b>Bondkopf</b>	Ball-Wedge für Golddrähte Standardkapillare 16mm Läng (optional 19mm)
<b>Ultraschall System</b>	F&S Generator 67kHz (optional 100, 120, 140kHz)

### Maschinen Basis

<b>Achsen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmierbare lineare Z-Achse mit 60mm Hub</li> <li>• Schrittauflösung: 1 µm</li> <li>• Standard-Arbeitshöhe: 55 mm</li> <li>• Manipulator in X und Y: 18x18 mm</li> <li>• entspricht Untersetzung: 1:7</li> </ul>
<b>Hardware</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stepper-Motor getriebene Z-Linearachse,</li> <li>• Singleboard-PC, menügeführtes Teach-In,</li> <li>• interne Festplatte, Bedienung und Menü-Führung über Shuttlerad mit Quittierungstaster</li> </ul>
<b>Software</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• programmierbare Einzelbonds</li> <li>• Loopformen speicherbar</li> </ul>
<b>Steuerung</b>	Manuell
<b>Abmessung</b>	B x T x H – 63 x 58 x 40 cm, Gewicht ca. 30kg
<b>Anschlüsse</b>	100-230 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 230 VA Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch
<b>Heizung</b>	Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C

### Die 53xx Serie:

Der Gold-Ballbonder 5310 verarbeitet Golddrähte von 17,5 bis 50 µm, sowohl im Bumpingmodus als auch im Stitchbondmodus. Durch die motorgesteuerte Bewegung in der Z-Achse haben Sie stets reproduzierbare Bondergebnisse.

Zusätzlich können sämtliche Parameter auf der internen Festplatte gespeichert werden. Die Bedienführung über ein Farbdisplay und die Eingabe durch ein Wählrad machen die Programmierung und die Handhabung sehr einfach. Der Operator kann durch das Manipulatorsystem verschiedene Looparten erzeugen. Das erlaubt die Bedienung auch durch wenig geschultes Personal.

Wenn auch Sie für komplexe Bondaufgaben, optimale Qualität zum günstigen Preis suchen, ist diese Maschine genau richtig für Sie.

## Substrathalter

Standard-Substrataufnahme  
Mit mechanischer Klemmung  
Ø80mm



### Optional:



Substrataufnahme  
für Bauteile bis 4x4" mit  
Vakuum und mech. Klemmung



TO Aufnahme mit  
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.  
gummierter Oberfläche, mit  
mechanische Klemmung

### F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270

Fax: +43-7722-67052-8272

Mail: [info@fsbondtec.at](mailto:info@fsbondtec.at)

Web: [www.fsbondtec.at](http://www.fsbondtec.at)

